

長華科技股份有限公司 (6548)

2016/12/28

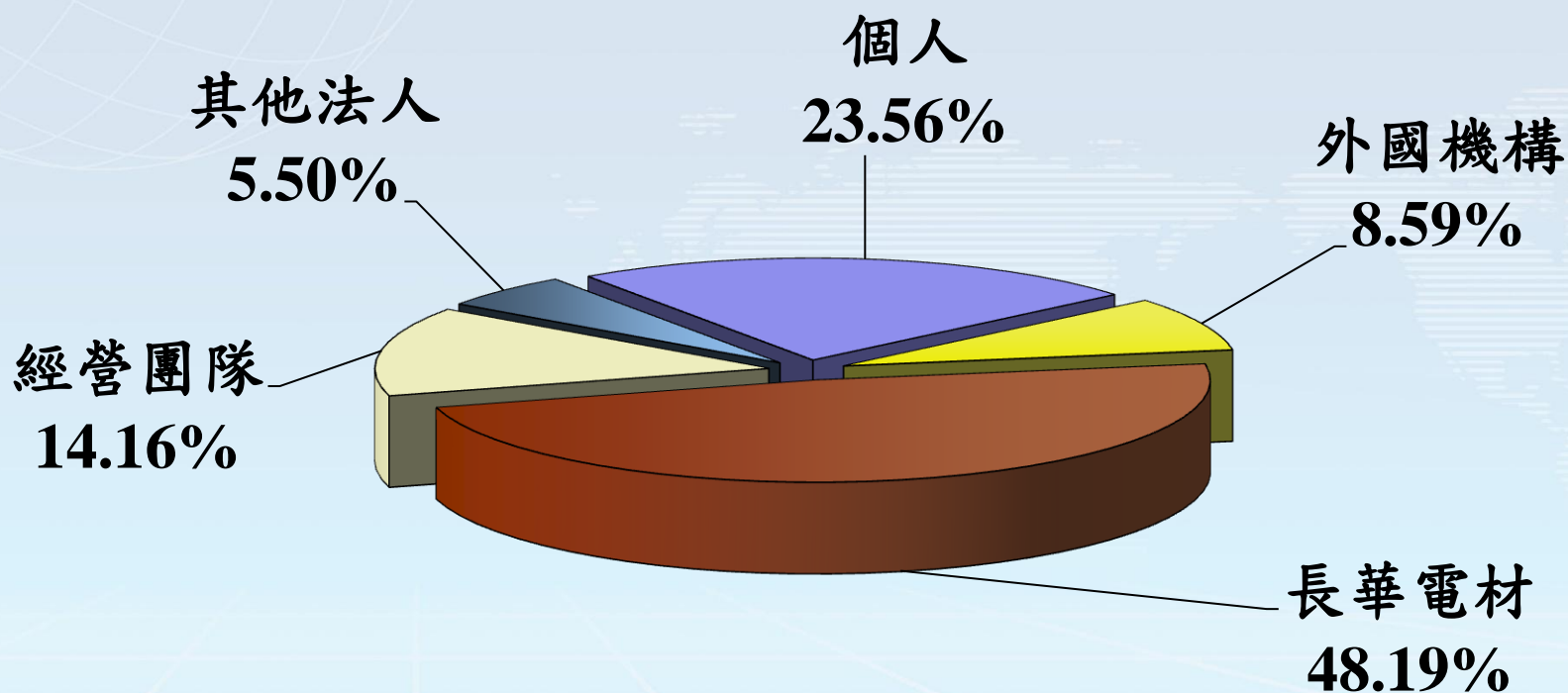
大綱

- 一、公司簡介
- 二、產品與客戶
- 三、營運概況
- 四、MLB專案
- 五、購併SHAP綜效
- 六、技術發展

一、公司簡介

設立日期	2009年12月24日
董事長	黃嘉能
實收資本額	新台幣2.45億元
員工人數	144人
主要產品	Pre-Mold Metal Substrate
轉投資	長科實業(上海)有限公司
總公司/工廠	高雄市楠梓加工出口區

股東結構(2016.11)



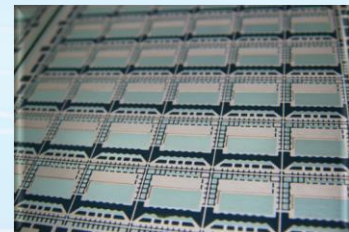
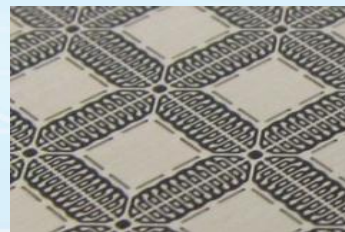
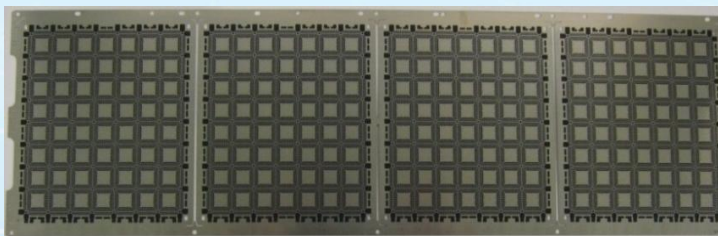
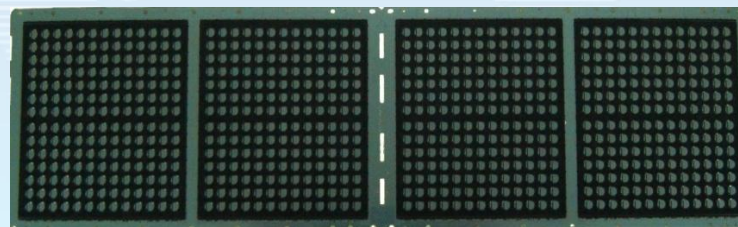
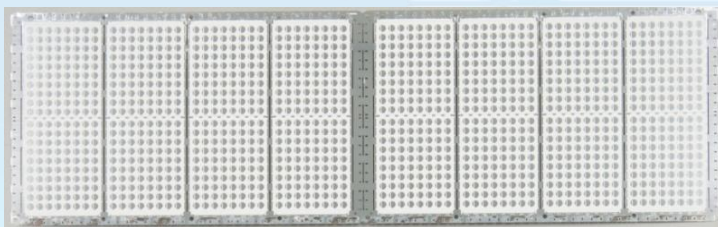
註：以已發行股數24,505千股計算。

二、產品與客戶


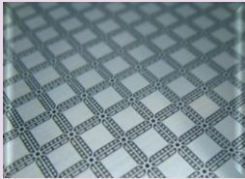
產品沿革

年度	2009~2012	2012~2016	2017~
主要產品	LED PPA 導線架	LED EMC 導線架	IC金屬導線架
			Pre-Mold Metal Substrate
			LED EMC導線架

LE
D
I
C



產品應用

品項	產品應用	終端應用
<p>LED EMC 導線架</p> 	<p>LCD 顯示器背光模組 照明模組</p>	<p>LCD TV 戶外看板 室內外照明</p>
<p>Pre-Mold Metal Substrate (IC : QFN、DFN..)</p> 	<p>IC 封裝金屬載板</p>	<p>車用IC(自動駕駛) 工業用IC 醫療用IC (高可靠度、耐候型IC封裝)</p>

Pre-Mold Metal Substrate 客戶群

- OSATs (長華現有客戶)
- IDM、OSATs (S.H.M導線架客戶)
- China Local Customer(新開發)

三、營運概況

102年~104年及105前三季損益

單位:新台幣仟元

項目 \ 年度	最近三年度損益表			105前三季
	102年度	103年度	104年度	
營業收入	343,247	393,939	378,404	346,235
營業毛利	73,689	131,804	116,664	107,011
毛利率	21.47%	33.46%	30.83%	30.91%
營業利益	49,774	74,453	62,320	50,913
稅前淨利	25,979	74,399	75,945	40,763
稅後淨利	21,532	62,644	58,508	34,296
基本每股盈餘(元)	1.6	4.09	2.66	1.55
已發行股數(千股)	15,206	22,006	22,006	24,505

籌資計畫

- 現增：2016年12月底遞件申辦現金增資5,500千股。
- 聯貸：預計2017年1Q辦理銀行聯貸新台幣40億元。
- 用途：聯貸資金專款用於MLB專案以及未來營運資金。

四、MLB專案

A faint, light blue world map is visible in the background, centered behind the main title. The map shows the outlines of continents and is rendered with a grid of latitude and longitude lines.

MLB專案時空背景

- S.M.M的考量
- 長華集團的考量

- S.M.M於2016年11月11日宣布透過旗下子公司S.H.M將導線架生產據點(亞太營運中心SHAP)出售給長華及長華科。
- 目前SHAP營收規模約佔S.H.M全部金屬導線架營收之70~75%。

S.H.M 為全球最大且技術領先

WORLD WIDE TOP 5 LEADFRAME MARKET SHARE FOR 2014

Supplier	2014 Rank	2014 Revenues U\$ M	2014 % Market Share
SHM	1	357 M(USD)	11.10%
Mitsui High-tec	2	331 M(USD)	10.30%
Shinko Electric	3	282 M(USD)	8.80%
SDI	4	271 M(USD)	7.60%
ASM Pacific	5	245 M(USD)	5.60%

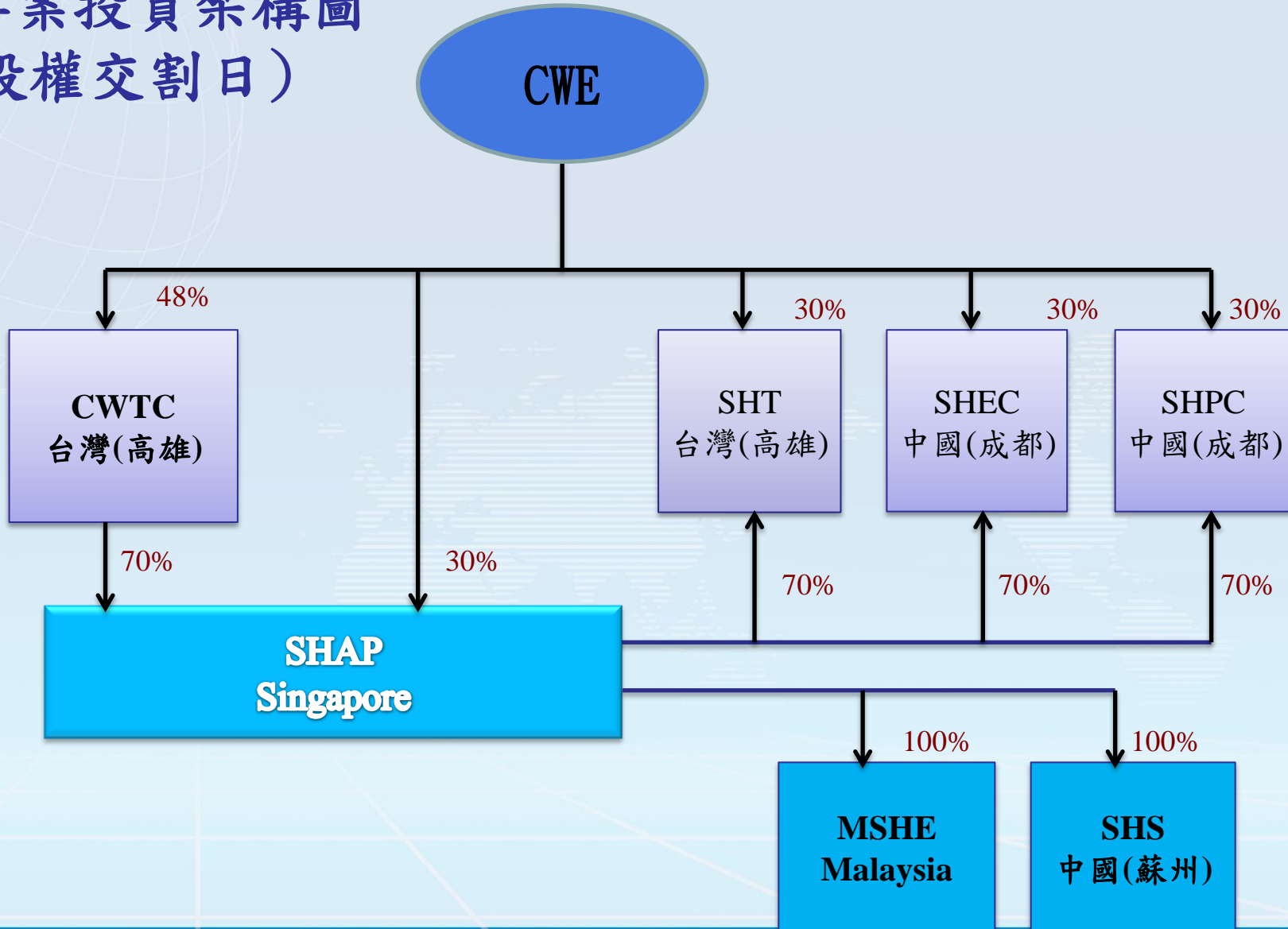
Source : SEMI Industry Research

WORLD WIDE TOP 5 LEADFRAME MARKET SHARE FOR 2015

Supplier	2015 Rank	2015 Revenues \$M	2015 % Market Share
SHM	1	347 M(USD)	11.60%
Mitsui High-tec	2	331 M(USD)	11.00%
SDI	3	290 M(USD)	9.69%
Shinko Electric	4	242 M(USD)	8.09%
ASM Pacific	5	227 M(USD)	7.58%

Source : SEMI Industry Research

MLB專案投資架構圖 (股權交割日)



五、購併SHAP綜效

垂直整合

- 往上一材料支援。
- 往下一完整出海口。

長華科取得S. H. M旗下SHAP之70%股權

- 合併營收：預計2017年3月31日完成股權交割，同年4月1日開始認列全部之SHAP營收。
- 獲利：依持股比認列SHAP之70%獲利。
- 客戶：取得SHAP客戶，積極推廣Pre-Mold金屬基板。
- 客製化原材：提供更優質原材，強化競爭力。

六、技術發展

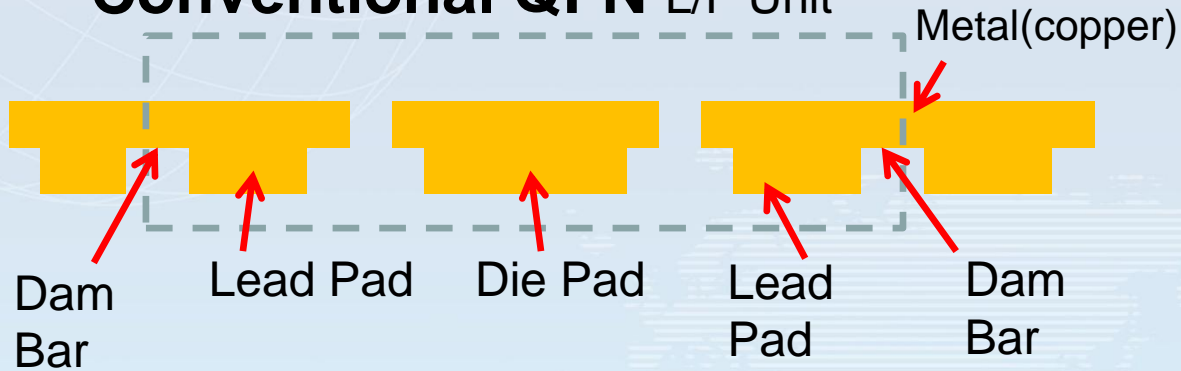
The background features a light blue gradient with a faint world map and a grid pattern. A large, semi-transparent globe is visible on the left side of the slide.

What is Pre-Mold

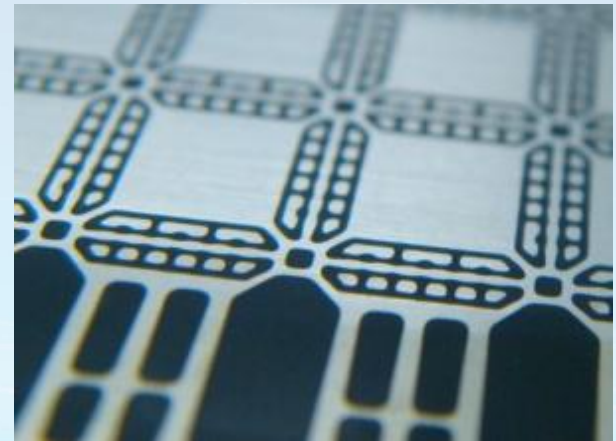
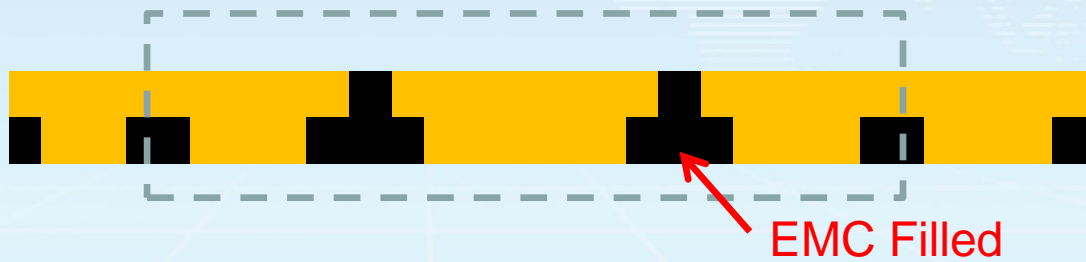
Structure

X-Section View

Conventional QFN L/F Unit



QFN Pre-Mold L/F Unit



How is Pre-Mold Features

- No need of back side tape



No flash issue on back side when packing

- Good wire bondability



Solid support for wire bond process

- Reliable Flip Chip bondability



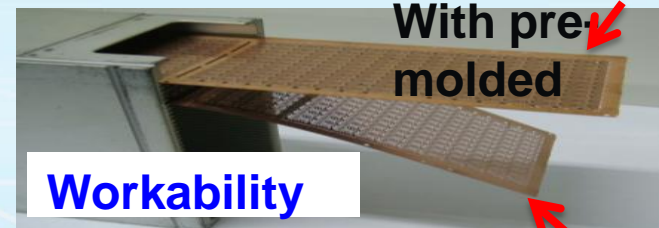
Solid support for solder joint in F/C application

1. No more yield loss by mold flash!
2. Increase W/B UPH
3. FC Bonder /UPH ++
No more bump crack during handling!!!

Without pre-molded



With pre-molded



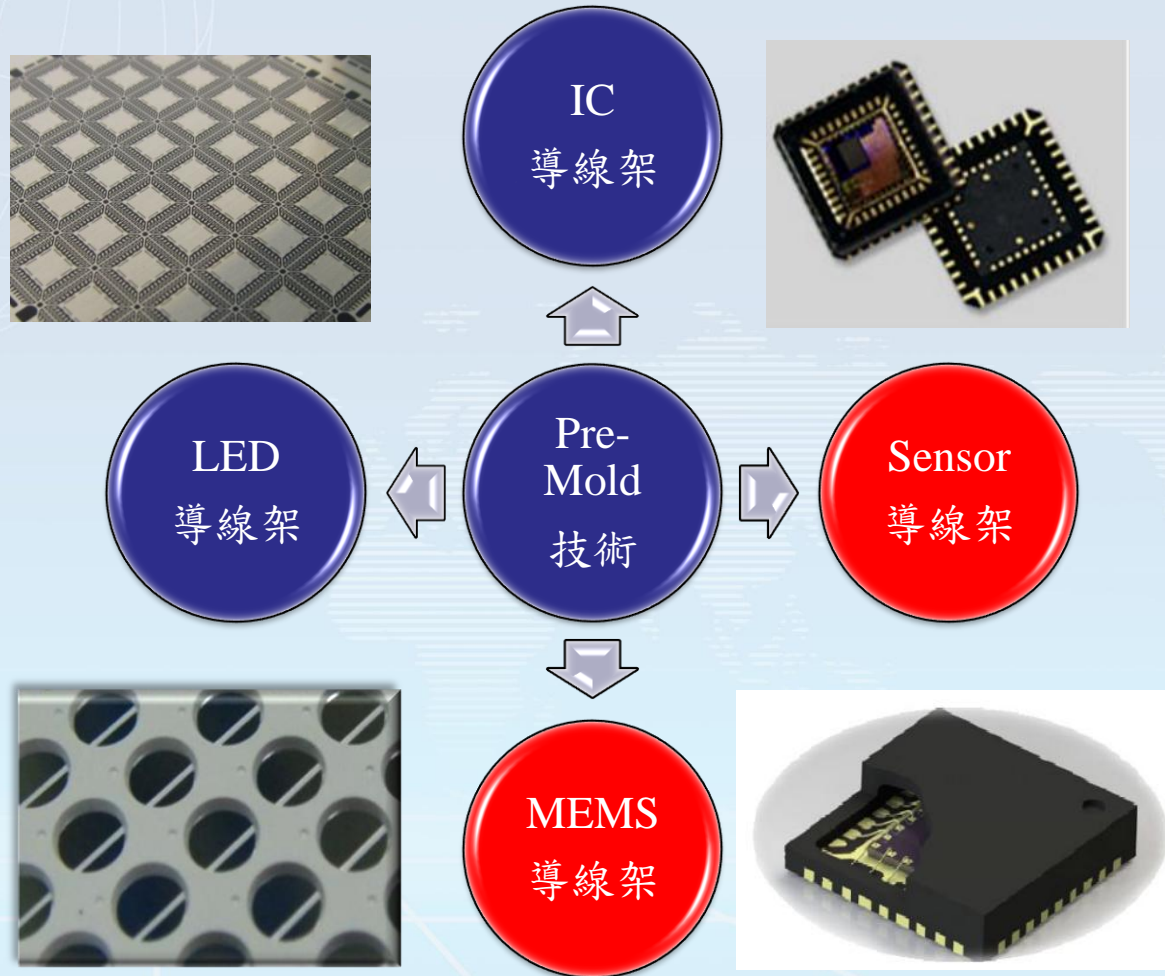
Without pre-molded

PreMold QFN Advanced Advantage

With Rigid and Flat property of PreMold QFN , allow designer to re-layout the pattern(Die pad and Lead) to achieve :

1. Long lead design
2. Irregular lead and die pad design
3. High I/O count
4. Better Adhesion

Pre-Mold技術之產品應用



A light blue background with a faint world map and a grid pattern. The map is centered behind the text. The grid consists of thin white lines forming a perspective view of a floor or a grid.

Thank You